

GX103 系列 WLCSP 封装、兼容 SMBus 和 I²C 通信的低功耗数字温度传感器

1 基本性能

- 多芯片访问（Multiple Device Access, MDA）
——全局读写操作
- 测温范围：-40°C ~ +125°C
- 测温精度：±1°C（-40°C ~ +125°C）
- 封装：4-Ball WCSP（DSBGA）
- 电源电压
GX103x：1.4V ~ 2.8V
GX103S：1.4V ~ 3.6V
- 低静态电流
正常工作：≤3μA（0.25Hz）
关断模式：≤1μA
- 分辨率
GX103x：8Bits
GX103S：11Bits
- 数字输出：兼容SMBus、I²C接口

2 应用场景

- 手机
- 笔记本电脑
- 固态硬盘（SSDs）
- 服务器
- 机顶盒
- 低功耗环境
- 传感器

3 芯片概述

GX103 系列温度传感器均采用 4-Ball 晶圆级封装，其中 GX103x 的测温分辨率为 1°C，GX103S 的测温分辨率为 0.125°C。

GX103 系列的两线接口兼容 SMBus 和 I²C 通信方式，并支持多芯片访问（MDA）命令，可实现主机同时与总线上多个芯片进行通信，无需向每个 GX103 系列芯片单独发送读写命令。其中 GX103x 支持在一条主线上最多挂载 8 个不同地址芯片，GX103S 支持挂载 16 个不同地址芯片。

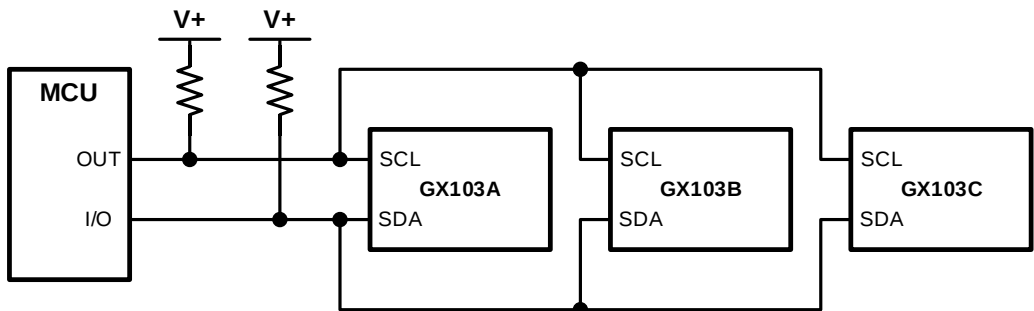
GX103 系列适用于测温区域受限、对温度敏感、需对多温度区域进行测量监控的系统中。GX103 系列额定工作温度范围均为-40°C ~ +125°C。

芯片信息

产品编号	封装信息	芯片主体面积
GX103x	WLCSP-4	0.86 mm × 0.86 mm
GX103S	WLCSP-4	0.86 mm × 0.86 mm

注：“x”代表不同地址 A/B/C。

GX103 系列应用框图



9 订购信息

订购编号	芯片型号	封装信息	标准包装数量	备注
GX103A-T&R	GX103A	WLCSP	4000	卷带包装 (Tape & Reel)